

23	晶圓針測製程外包模式之探討與改善-以聯華電子為例	
指導教授	陳飛龍	博士
參與學生	U890839 李志彥	
摘 要		
本專題主要探討晶圓廠在針測製程之外包行為中一些簡單的方法論，藉由本人實習之經驗與實務操作對此模式之了解做一概要之敘述。本專題之大綱如下： 1. 晶圓針測製程簡介：介紹晶圓針測的整個流程，並簡單敘述其中可能發生之問題及聯電一般管理針測製程的方法。 2. 聯電現況及外包情形：描述聯電現今之針測製程情況及外包之理由，以及聯電對於外包之晶圓如何做帳務上之處理。為了與外包廠間取得良好合作與溝通，需要哪些注意事項等。 3. 聯電對於外包廠之管理監控手法：為本專題最主要之部分，聯電為了彌補自身產能之不足而採取外包方法，但所衍生的問題即是外包的晶圓，其測試過程因在外包廠進行，聯電無法全程予以監控，故發展出一些監控管理手法來對外包廠做有效之控管。此處所指者並非監控晶圓之良率，因良率在晶圓製造出來時便已決定；對於外包廠所要求的，是他們所回傳之資料的準確性與可靠性，此外聯電也建立了一些指標來評估各外包廠之表現，本章節將對此手法及這些指標做一扼要之說明。 4. 聯電現行與外包廠間之溝通方法與改善：在我實習之過程中，了解到當貨品出現問題時，聯電的工程師與外包廠間是如何溝通的，經由什麼樣的介面，管道去溝通，這些管道中存在一些疏失，既使得溝通麻煩，也浪費寶貴的時間。本章將介紹聯電正在改善開發的新介面，以及我經由觀察所得之其他方面的小建議。 5. 結語：簡述本次實習之心得與所學得之實務經驗。		